

先端半導体のデバイス工程を支える加工技術

2025年の半導体市場は、人工知能（AI）や高性能コンピューティング（HPC）、WBG半導体（SiC、GaNなど）の需要拡大を背景に、世界的に大きな成長が見込まれています。半導体の製造工程は、「ウエハ製造」と、半導体チップを作り込む「前工程」、チップを切り出してパッケージ化し完成させる「後工程」から成り、「前工程」や「後工程」においても「プラナリゼーションCMP」、「バックオフ」、「ダイシング」などの機械加工技術が重要な役割を果たしています。そこで、本研究会では、先端半導体製造の現場で直面している課題についてメーカーの立場から解説頂くと共に、先端半導体のデバイス工程を支える加工技術に関わる著名な研究者・技術者の方々に講演していただきます。

主 催：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日 時：2025年12月19日（金） 13:00～17:00

開催方式：下記会場（対面）とCisco Webex Meeting
（Web）のハイブリッド形式で開催します。

日本大学 理工学部 駿河台キャンパス

1号館 6階 CSTホール

当日連絡先：03-3259-0404



URL：<https://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/surugadai/>

※ 講演者には開催前の状況により、対面かWebのどちらでの講演かを選択して頂きます。

※ Web開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。

13:00～13:05	開会挨拶	委員長 日本大学 山田 高三 氏
13:05～13:55	講演1 電動車用パワー半導体のデバイスとプロセス技術の開発	(株)ミライズテクノロジーズ 藤原 広和 氏
13:55～14:45	講演2 触媒表面基準エッチング法および高圧カプラズマを用いたエッチングのデバイス工程への応用 (web講演)	大阪大学 佐野 泰久 氏
14:45～15:05	<休憩>	
15:05～15:55	講演3 ウォータガイドレーザ加工技術の半導体分野への適用	(株)牧野フライス製作所 平野 舜也 氏
15:55～16:45	講演4 「次世代半導体技術」の重要性と砥粒加工の役割	(株)岡本工作機械製作所 倉知 雅人 氏
16:45～16:55	閉会挨拶・事務連絡	
17:10～19:10	技術交流会 同じ会場の2階 カフェテリア	

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料、非会員：15,400円（税抜額14,000円＋消費税1,400円）、非会員アカデミア：6,600円（税抜額6,000円＋消費税600円）、学生：無料

※会員は5人／社まで、非会員は2人／社まで研究会に参加できます。

技術交流会：会員資格に関わらず2名／社まで参加できます。3人目からは4,950円／人（税抜額4,500円＋消費税450円）を徴収します。

（注）「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意ください。

申込締切日：2025年12月4日（木）

（注）当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会事務局

・FAX：048-858-3709、E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

・申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>